目　　录

.....1
.....1
.....1
.....2
.....2
1．仪器仪表的选择与使用.....2
2. 电子元器件的识别和检测.....2
3．电子工程图的识读.....3
4．常用装配工具的选择与使用.....3
5．电子产品工艺文件的使用.....4
6．电子元器件的预处理与插装.....4
7. 电子线路的手工焊接.....5
8．电子产品的电路调试.....6
9．电子产品的电路故障检修.....6
10．电子产品装配质量检验.....7
.....9
1．硬件电路的手工装配.....9
2．硬件电路调试.....9
3．仪器仪表选择和操作.....10
4. 常用工具软件的使用.....11
5. 工艺文件编写.....11
6 程序代码编写.....12
.....13
.....13
1. 电子元器件的识别和测试.....13
2．仪器仪表的选择与使用.....14
3．电子工程图的识读.....14
4. 程序代码编写.....15
5. 嵌入式系统综合调试与测试.....15
.....17
1. 移动应用开发环境搭建.....17
2. 移动应用 UI 设计.....17
3. 移动应用人机交互设计.....18
4. 移动应用程序代码编写.....19
5. 移动应用程序综合调试.....19
..... 21
1 21
2 21
3 21

..... 25
1 25
2 25
3 26
..... 26

610115

)

1. 仪器仪表的选择与使用

&)

B(B (B (C C& &)0.

/ ! ″

(

2. 电子元器件的识别和检测

&)

B(B (C C& &)0.

/ ! ″

(

3．电子工程图的识读

&)

B(B &00 ((-0 1

/ ! ″

((

4．常用装配工具的选择与使用

&)-

B(B &00 (C&

/ ! ″

((

5．电子产品工艺文件的使用

&).

B(B & &/) (C&

/ ! ″

((

6．电子元器件的预处理与插装

&)/

B (B & &/) (C&

B & &/)

/ ! ″

((

7. 电子线路的手工焊接

&)0

B (B & &/) (C&

/ ! ″

((

8．电子产品的电路调试

&)1

B(B & &/) (C&

/ ! ″

((

9．电子产品的电路故障检修

&)2

B (B & &/) (C&

/ ! ″

((

10. 电子产品装配质量检验

&)

B (B & &/) (C&

B & &/)

B & &/)

B & &/)

/ ! ″

((

/

1．硬件电路的手工装配

&)

/ ! ″

((

/ ! ″

((

3．仪器仪表选择和操作

&)

/ ! ″

((

4. 常用工具软件的使用

&)-

D

D

/ ! ″

((

5. 工艺文件编写

&).

/ ! ″

((

6 程序代码编写

&)/

/ ! ″

((

F)

&F D F D

.

1. 电子元器件的识别和测试

&)

B(B (C C& &)0.

/ ! ″

(

2．仪器仪表的选择与使用

&)

B(B (B (C C& &)0.

/ ! ″

(

3．电子工程图的识读

&)

B(B &00 ((-0 1

–

/ ! ″

((

4. 程序代码编写

&)–

/ ! ″

((

5. 嵌入式系统综合调试与测试

&).

.

1. 移动应用开发环境搭建

–&)

–

/ ! ″

((

2. 移动应用 **UI** 设计

–&)

B

/ ! ″

((

3. 移动应用人机交互设计

–&)

B

B

–

/ ! ″

((

4. 移动应用程序代码编写

–&)–

/ ! ″

((

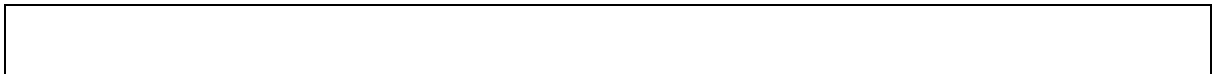
5. 移动应用程序综合调试

–&).

/ ! ″

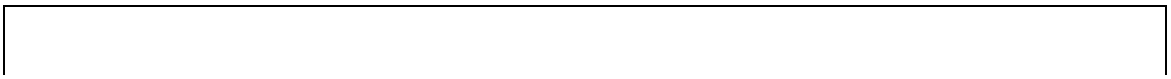
((

1



!.）〃		.		0
		.		
		）		
		.		
		.		
		）		
	/	）	6S	
.）		.		
		.		
		）		
		.		
		.		

!.) 〃		.		0
		.		
		.		
		)		
		.		
		)		
	/	)	6S	
.)		.		
		.		
		)		
		.		
		.		



3

2

表 2 考核内容与考核方式

					( )
					180
					180
		STM32	STM32		120
		AndroidStudio	AndroidStudio		120

C& &))

B & &/) ! ″ B & &/)

B &00 (

- (-.0&))/

. (1.//&))0

/ (1./0&))/